

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

12.12.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

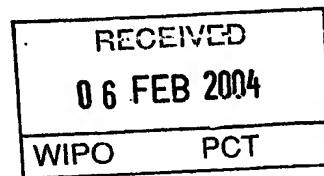
This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office.

出願年月日  
Date of Application: 2003年10月 3日

出願番号  
Application Number: 特願2003-346083

[ST. 10/C]: [JP2003-346083]

出願人  
Applicant(s): タテホ化学工業株式会社

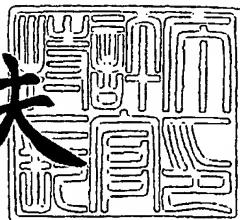


PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 1月 23日

特許長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



**【書類名】** 特許願  
**【整理番号】** KP-10795  
**【提出日】** 平成15年10月 3日  
**【あて先】** 特許庁長官殿  
**【発明者】**  
**【住所又は居所】** 兵庫県赤穂市加里屋字加藤 974 番地 タテホ化学工業株式会社  
**【氏名】** 内  
**【氏名】** 清川 敏夫  
**【発明者】**  
**【住所又は居所】** 兵庫県赤穂市加里屋字加藤 974 番地 タテホ化学工業株式会社  
**【氏名】** 内  
**【氏名】** 山元 香織  
**【発明者】**  
**【住所又は居所】** 兵庫県赤穂市加里屋字加藤 974 番地 タテホ化学工業株式会社  
**【氏名】** 内  
**【氏名】** 國重 正明  
**【特許出願人】**  
**【識別番号】** 000108764  
**【氏名又は名称】** タテホ化学工業株式会社  
**【代理人】**  
**【識別番号】** 100078662  
**【弁理士】**  
**【氏名又は名称】** 津国 肇  
**【電話番号】** 03(3502)7212  
**【選任した代理人】**  
**【識別番号】** 100075225  
**【弁理士】**  
**【氏名又は名称】** 篠田 文雄  
**【選任した代理人】**  
**【識別番号】** 100113653  
**【弁理士】**  
**【氏名又は名称】** 東田 幸四郎  
**【手数料の表示】**  
**【予納台帳番号】** 023836  
**【納付金額】** 21,000円  
**【提出物件の目録】**  
**【物件名】** 特許請求の範囲 1  
**【物件名】** 明細書 1  
**【物件名】** 要約書 1  
**【包括委任状番号】** 0002095

**【書類名】特許請求の範囲****【請求項1】**

表面が複酸化物により被覆され、かつ、平均形状係数が1.25以下であることを特徴とする球状被覆酸化マグネシウム粉末。

**【請求項2】**

前記複酸化物の融点が2773K以下である、請求項1記載の球状被覆酸化マグネシウム粉末。

**【請求項3】**

前記複酸化物がアルミニウム、鉄、ケイ素及びチタンからなる群から選択される1以上の元素とマグネシウムとを含む、請求項2記載の球状被覆酸化マグネシウム粉末。

**【請求項4】**

前記複酸化物を5~50mass%含む、請求項1~3のいずれか1項記載の球状被覆酸化マグネシウム粉末。

**【請求項5】**

平均粒径が $5 \times 10^{-6} \sim 500 \times 10^{-6}$ mであり、BET比表面積が $5 \times 10^3 \text{ m}^2 / \text{kg}$ 以下である、請求項1~4のいずれか1項記載の球状被覆酸化マグネシウム粉末。

**【請求項6】**

酸化マグネシウム粉末の表面に、複酸化物を形成する元素の化合物を存在させたのち、高温で溶融させることにより、前記酸化マグネシウム粉末表面を複酸化物で被覆すると共に球状化することを特徴とする球状被覆酸化マグネシウム粉末の製造方法。

**【請求項7】**

マグネシウムと複酸化物を形成する元素の化合物がアルミニウム化合物、鉄化合物、ケイ素化合物及びチタン化合物からなる群から選択される1以上の化合物である、請求項6記載の方法。

**【請求項8】**

被覆される酸化マグネシウム粉末の結晶子径が $50 \times 10^{-9}$ m以上である、請求項6又は7記載の方法。

**【請求項9】**

火炎温度が2073K以上である、請求項6~8のいずれか1項記載の方法。

**【請求項10】**

請求項1~5のいずれか1項記載の球状被覆酸化マグネシウム粉末を含む樹脂組成物。

**【請求項11】**

前記樹脂組成物の樹脂がエポキシ樹脂である、請求項10記載の樹脂組成物。

**【請求項12】**

前記樹脂組成物の樹脂がシリコーンゴムである、請求項10記載の樹脂組成物。

**【請求項13】**

請求項10~12のいずれか1項記載の樹脂組成物を用いた電子デバイス。

**【書類名】明細書**

**【発明の名称】**球状被覆酸化マグネシウム粉末及びその製造方法及びその粉末を含む樹脂組成物

**【技術分野】****【0001】**

本発明は、耐湿性に優れ、かつ充填材として用いるとき、充填性に優れた球状被覆酸化マグネシウム粉末及びその製造方法及びこの球状被覆酸化マグネシウム粉末を含む樹脂組成物、並びにその樹脂組成物を用いた電子デバイスに関する。

**【背景技術】****【0002】**

電子デバイスは、積層体、プリント配線板、多層配線板等の電子部品により構成されている。電子部品には、通常、樹脂組成物がプリプレグ、スペーサー、封止剤、接着性シート等に用いられており、樹脂組成物には、様々な性能又は特性が要求されている。例えば、最近の傾向として、電子デバイスにおける大容量パワー素子搭載、高密度な実装が見られ、それに伴い樹脂組成物及びその適用品に対し従来よりも更に優れた放熱性、耐湿性が要求されている。

**【0003】**

例えば、半導体封止用の樹脂組成物に用いるフィラーは、従来、二酸化ケイ素（以下、シリカという）、酸化アルミニウム（以下、アルミナという）が用いられてきた。しかし、シリカの熱伝導性は低く、高集積化、高電力化、高速化等による発熱量の増大に対応する放熱が充分ではないため、半導体の安定動作等に問題が生じていた。一方、シリカより熱伝導性が高いアルミナを使用すると、放熱性は改善されるが、アルミナは硬度が高いために、混練機や成型機及び金型の摩耗が激しくなるという問題点があった。

**【0004】**

そこで、シリカに比べて熱伝導率が1桁高く、アルミナと約同等の熱伝導率を有する酸化マグネシウムが半導体封止用樹脂フィラーの材料として検討されている。しかし、酸化マグネシウム粉末は、シリカ粉末に比べ、吸湿性が大きい。そのため、半導体の封止用樹脂フィラーとして酸化マグネシウム粉末を用いた場合、吸湿した水と酸化マグネシウムが水和して、フィラーの体積膨張によるクラックの発生、熱伝導性の低下等の問題が発生していた。こうして、半導体封止用樹脂フィラーとして用いる酸化マグネシウム粉末に耐湿性を付与することが、半導体の長期的な安定動作を保証する上で大きな課題となっていた。

**【0005】**

酸化マグネシウム粉末の耐湿性を改善させる方法として、アルミニウム塩又はケイ素化合物と酸化マグネシウム粉末を混合し、固体分をろ別し、乾燥させて、焼成することにより、該酸化マグネシウム粉末の表面を、アルミニウム又はケイ素とマグネシウムの複酸化物を含む被覆層で被覆することを特徴とする被覆酸化マグネシウム粉末の製造方法が提案されている（特許文献1、2参照）。

**【0006】**

これらの方法により得られた被覆酸化マグネシウム粉末は耐湿性が改善されたものの、粉末粒子は角張った形状をしているため、樹脂への充填性が低く、さらに得られた樹脂組成物の流動性が低いという問題がある。

**【0007】**

一方、酸化マグネシウム粉末に対し、アルミナ及び／又はシリカ粒子を添加し、これをスプレードライヤーを用いて粒状化して球形顆粒物を得たのち、かかる粒状化状態を崩すことなく、前記造粒物の少なくとも一部を溶融し、次いでこれを急速に冷却する酸化マグネシウム系物質の製造方法も提案されている（特許文献3）。

**【0008】**

この方法は、酸化マグネシウム粉末の耐湿性を向上させることを目的としているが、スプレードライヤーを用いて粒状化するため、得られた球形顆粒物は粒子の集合体すなわち

多孔質体であり、樹脂へ高充填することは困難であると予測できる。

【特許文献1】特開2003-34522号公報

【特許文献2】特開2003-34523号公報

【特許文献3】特許第2590491号

#### 【発明の開示】

#### 【発明が解決しようとする課題】

##### 【0009】

本発明の目的は、上記の課題を解消し、耐湿性に優れ、かつ樹脂などへの充填材として用いる際の充填性に優れ、さらに、充填後の樹脂組成物の流動性が高く、その結果成型性に優れた球状被覆酸化マグネシウム粉末を提供することであり、また、そのような球状被覆酸化マグネシウム粉末を容易に製造する方法及びこの球状被覆酸化マグネシウム粉末を含む樹脂組成物、並びに、この樹脂組成物を用いた電子デバイスを提供することである。

##### 【課題を解決するための手段】

##### 【0010】

本発明者は、上記目的を達成すべく、粒子の平均形状係数に着目して、被覆酸化マグネシウム粉末の形状について種々検討を重ねた結果、最適な平均形状係数の範囲を見出して本発明を完成するに至った。

##### 【0011】

また酸化マグネシウム粉末の表面に、融点が2773K以下の複酸化物を形成する元素の化合物を存在させ、高温中で溶融させることにより、容易に球状被覆酸化マグネシウム粉末を製造する方法を見出した。

##### 【0012】

すなわち、本発明によれば、表面が複酸化物により被覆され、かつ、平均形状係数が1.25以下であることを特徴とする球状被覆酸化マグネシウム粉末が提供される。

##### 【0013】

また、本発明によれば、酸化マグネシウム粉末の表面に、複酸化物を形成する元素の化合物を存在させたのち、高温で溶融させることにより、前記酸化マグネシウム粉末表面を複酸化物で被覆すると共に球状化する球状被覆酸化マグネシウム粉末の製造方法が提供される。

##### 【0014】

さらに、本発明によれば、上記の球状被覆酸化マグネシウム粉末を含む樹脂組成物、及びそのような樹脂組成物を使用した電子デバイスが提供される。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

##### 【0015】

本発明の球状被覆酸化マグネシウム粉末は、その表面が複酸化物により被覆され、かつ、平均形状係数が1.25以下であるものである。

ここで、形状係数は、粒子の投影像において $(\text{周囲長})^2 / (4\pi \times \text{面積の和})$ で表される値であり、粒子の投影像が真円の場合に1となり、数値が大きくなるほど不規則形状であることを示している。

##### 【0016】

本発明で用いられる平均形状係数は、レーザー顕微鏡と画像解析ソフトを使用して粒子100個の形状係数を求め、その平均値として得られた数値である。

##### 【0017】

樹脂に対する粉末の充填率を向上させるためには、粉末の形状を球状に近づける必要がある。本発明によれば、球状被覆酸化マグネシウム粉末の平均形状係数は、1.25以下であることが必要であり、好ましくは1.22以下であり、より好ましくは、1.20以下である。

平均形状係数が1.25以下であると、樹脂への充填性が向上し、しかも得られた樹脂組成物の流動性も優れたものとなる。

##### 【0018】

本発明の球状被覆酸化マグネシウム粉末はその表面が複酸化物で被覆されている。この複酸化物で被覆する第一の目的は、酸化マグネシウム粉末の耐湿性を改善するためであり、第二の目的は、酸化マグネシウム粉末の球状化処理工程を容易にするためである。つまり、酸化マグネシウム粉末の表面に、火炎温度より融点が低い複酸化物を形成させ、酸化マグネシウム粉末の表面を低融点化することにより、球状化を容易にすることができます。複酸化物の融点は、2773K以下が好ましく、2273K以下がより好ましい。

#### 【0019】

この酸化マグネシウム粉末の表面を被覆する複酸化物は、具体的には、アルミニウム、鉄、ケイ素及びチタンからなる群から選択される1以上の元素とマグネシウムとを含むものであることが好ましい。

具体的には、フォルステライト ( $Mg_2SiO_4$ )、スピネル ( $Al_2MgO_4$ )、マグネシウムフェライト ( $Fe_2MgO_4$ )、チタン酸マグネシウム ( $MgTiO_3$ )などをあげることができる。

#### 【0020】

本発明で用いる複酸化物の含有量、すなわち、1個の粒子に対する表面の複酸化物の割合は、5～50mass%が好ましく、10～40mass%がより好ましい。複酸化物の含有量が上記の範囲にあると、酸化マグネシウム粉末の表面が複酸化物により完全に被覆されて球状化が容易となり、樹脂への高充填が可能となり、さらには、充填後の樹脂組成物の熱伝導率も高く、熱伝導性フィラーとして十分な効果を発揮することができる。

#### 【0021】

本発明の球状被覆酸化マグネシウム粉末の平均粒径は、 $5 \times 10^{-6} \sim 500 \times 10^{-6}$ mが好ましく、 $10 \times 10^{-6} \sim 100 \times 10^{-6}$ mがより好ましい。またBET比表面積は、 $5.0 \times 10^3 m^2/kg$ 以下が好ましく、 $1 \times 10^3 m^2/kg$ 以下がより好ましい。

#### 【0022】

次に、本発明の球状被覆酸化マグネシウム粉末は、酸化マグネシウム粉末の表面に、複酸化物を形成する元素の化合物を存在させたのち、高温で溶融させることにより、前記酸化マグネシウム粉末表面を複酸化物で被覆すると共に球状化して製造する。

#### 【0023】

一般に、粉末の形状を球状に近づける方法としては、例えば、粉末を高温火炎中を通過させて溶融し、表面張力により球状にする方法が用いられている。この方法は、酸素燃焼による火炎温度(2073～2723K)より融点が低いシリカ、アルミナには適用することができるが、火炎温度より融点が高い酸化マグネシウム(融点3073K)には適用することができないため、酸化マグネシウムの球状化は困難であると考えられていた。

#### 【0024】

本発明の製造方法では、酸化マグネシウム粉末の表面に、火炎温度より融点が低い複酸化物を形成させ、酸化マグネシウム粉末の表面を低融点化させることにより、上記の高温火炎溶融工程を適用して球状化することが可能となる。この複酸化物の融点は、2773K以下が好ましく、2273K以下がより好ましい。

#### 【0025】

複酸化物を形成するために使用される化合物は、アルミニウム化合物、鉄化合物、ケイ素化合物及びチタン化合物からなる群から選択される1以上の化合物であることが好ましい。化合物の形態は限定されないが、硝酸塩、硫酸塩、塩化物、オキシ硝酸塩、オキシ硫酸塩、オキシ塩化物、水酸化物、酸化物が用いられる。

#### 【0026】

酸化マグネシウム粉末に対するこれらの化合物の配合量は、最終的に得られる球状被覆酸化マグネシウム粉末の複酸化物の含有量が5～50mass%となるように決定することが好ましい。

#### 【0027】

複酸化物を形成する元素の化合物として、例えば、ケイ素化合物を使用する場合は、乾

式シリカと酸化マグネシウム粉末を湿式で混合し、ろ過した後、乾燥し、表面にシリカを均一に吸着させた酸化マグネシウム粉末を得、この粉末を、酸素をキャリアガスとして、たとえば、プロパン-酸素の火炎中を通過させ、冷却後、捕集装置で捕集することにより、製造することができる。可燃性ガスは限定されないが、プロパン、ブタン、アセチレン、水素等の可燃ガス、又はこれらの混合ガスを用いることができる。

#### 【0028】

本発明で用いる酸化マグネシウム粉末の結晶子径は、 $50 \times 10^{-9}$  m以上であることが好ましい。結晶子径が $50 \times 10^{-9}$  m以上の酸化マグネシウム粉末は、より微細な粉末に比して反応性が低く、酸化マグネシウム粉末の表面にケイ素化合物等を均一に吸着させることができるために、粒子の球状化が均一に進行する。さらに酸化マグネシウム粉末の表面を均一に複酸化物で被覆できるため、耐水性が向上する。

#### 【0029】

本発明で使用する結晶子径は、X線回折法を用いて、Scherrer式で算出した値である。一般に、一つの粒子は複数の単結晶で構成された多結晶体であり、結晶子径は多結晶体中の単結晶の大きさの平均値を示している。

#### 【0030】

酸化マグネシウム粉末の純度は、特に限定されず、用途に応じて決定することが好ましい。例えば、電子部品の絶縁特性を満足するためには、純度90%以上であることが好ましく、純度95%以上であることがより好ましい。なお、本発明の特性を有する酸化マグネシウム粉末は、公知の方法、例えば、電融法、焼結法等を用いて製造することができる。

#### 【0031】

上記の製造方法により、低成本で容易に耐湿性、熱伝導性を維持しながら、樹脂への高い充填性を有する球状被覆酸化マグネシウム粉末を得ることができる。また、このようにして得られた球状被覆酸化マグネシウム粉末を充填した樹脂組成物は、良好な流動性を有し、成型性が改善される。

#### 【0032】

なお、本発明の製造方法において、酸化マグネシウム粉末の溶融球状化工程は、上述の火炎溶融工程に限定されるものではなく、所望の温度を実現し得る工程であれば、例えば、プラズマ加熱工程などを適用することも可能である。

#### 【0033】

本発明の樹脂組成物は、樹脂に上記の球状被覆酸化マグネシウム粉末を含有させて得られたものである。

その場合、本発明の球状被覆酸化マグネシウム粉末は、必要に応じてシラン系カップリング剤、チタネート系カップリング剤、アルミネート系カップリング剤で表面処理することができ、さらに充填性を向上することができる。

シラン系カップリング剤としては、ビニルトリクロルシラン、ビニルトリアルコキシシラン、グリシドキシプロピルトリアルコキシシラン、メタクロキシプロピルメチルジアルコキシシラン等が挙げられる。

チタネート系カップリング剤としては、イソプロピルトリイソステアロイルチタネート、テトラオクチルビス(ジトリデシルホスファイト)チタネート、ビス(ジオクチルパイロホスフェート)オキシアセテートチタネート等があげられる。

#### 【0034】

本発明の樹脂組成物に用いる樹脂は、特に限定されず、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂等の熱硬化性樹脂やポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、フッ素樹脂等の熱可塑性樹脂等があげられる。これらのうち、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂が好ましい。また、必要に応じて、硬化剤、硬化促進剤を配合することができる。

#### 【0035】

エポキシ樹脂としては、ビスフェノールAエポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールFエポキシ樹脂、臭素化エポキシ樹脂、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、グリシジルエステル系樹脂、グリシジルアミン系樹脂、複素環式エポキシ樹脂等があげられる。

#### 【0036】

フェノール樹脂としては、ノボラック型フェノール樹脂、レゾール型フェノール樹脂等があげられる。

#### 【0037】

シリコーン樹脂としては、ミラブル型シリコーンゴム、縮合型液状シリコーンゴム、付加型液状シリコーンゴム、UV硬化型シリコーンゴム等があげられ、付加型液状シリコーンゴムが好ましい。また、1液型及び2液型のシリコーンゴムのいずれでもよいが、2液型のシリコーンゴムが好ましい。

#### 【0038】

本発明の樹脂組成物には、上記の球状被覆酸化マグネシウム粉末の他に、充填材を配合することができる。充填材としては、特に限定されるものではなく、例えば、溶融シリカ、結晶シリカ等があげられる。また必要に応じて離型剤、難燃剤、着色剤、低応力付与剤等を適宜配合することができる。

#### 【0039】

本発明の電子デバイスは、上記樹脂組成物をその一部に用いたもので、優れた放熱性、耐湿性を有する。電子デバイスとしては、例えば、樹脂回路基板、金属ベース回路基板、金属張積層板、内層回路入り金属張積層板等があげられる。

#### 【0040】

本発明の樹脂組成物の上記の電子デバイスに対する用途としては、半導体封止剤、接着剤もしくは接着性シート、又は放熱シート、放熱スペーサーもしくは放熱グリース等があげられる。

#### 【0041】

本発明の樹脂組成物を用いて上記の基板等を製造するには、紙基材やガラス基材を本発明の樹脂組成物に浸漬し、加熱乾燥させてBステージまで硬化させて、プリプレグ（レジンクロス、レジンペーパー等）を製造する。

#### 【0042】

また、このプリプレグを用いて、樹脂回路基板、金属張積層板、内層回路入り金属張積層板等を製造することができる。例えば、金属張積層板は、プリプレグを基板厚さに応じて積み重ね、金属箔を置き、金型に挟みプレス機の熱盤間に挿入し、所定の加熱・加圧を行い積層板を成型し、更に成型した積層板の四辺を切断し、外観検査を行って製造する。また、本発明の樹脂組成物を他の基材材料と混合して、ガラスエポキシ、テフロンエポキシ等のような複合材料の形態で、基材として用いることもできる。

#### 【0043】

本発明の樹脂組成物は、封止材として用いることができる。封止用樹脂とは、半導体チップを機械的、熱的ストレス、湿度などの外的要因から保護するためのパッケージングに用いられる樹脂材料のことであり、本発明の樹脂組成物により形成されたパッケージの性能は、樹脂硬化物の熱伝導率及び耐候性により示される。

#### 【0044】

本発明の樹脂組成物は、接着剤として用いることができる。接着剤は、二つの物体を張り合わせるために使用される物質をいい、被接着体の材質は特に限定されるものではない。接着剤は、被接着体の表面に塗布又は係合されたとき、一時的に流動性を与えられ、接着後は流動性を失って固化するものである。例えば、溶剤接着剤、圧感接着剤、接着性シートのような熱感接着剤、反応接着剤が挙げられる。本発明の樹脂組成物を接着剤として用いた場合における接着後の熱伝導率及び耐候性は、樹脂硬化物の熱伝導率及び耐候性により示される。

#### 【0045】

また、本発明の樹脂組成物を接着剤として用い、金属ベース回路基板を製造することができる。金属ベース回路基板は、接着剤を金属板上に塗布し、接着剤がBステージ状態にあるときに金属箔を積層して、所定の加熱・加圧を行い、一体化して製造する。

#### 【0046】

また、本発明の樹脂組成物は、放熱材として用いることができる。放熱材としては、例えば、放熱シート、放熱スペーサー、放熱グリース等が挙げられる。放熱シートは、発熱性電子部品、電子デバイスから発生した熱を除去するための電気絶縁性の熱伝導性シートであり、シリコーンゴムに熱伝導性フィラーを充填して製造され、主として放熱フィン又は金属板に取り付けて用いられる。放熱グリースは、シリコーンゴムの代わりにシリコーンオイルを用いた以外は放熱シートと同じである。放熱スペーサーは、発熱性電子部品、電子デバイスから発生した熱を電子機器のケース等に直接伝熱するための、発熱性電子部品、電子デバイスとケースの間のスペースを埋める厚みを有したシリコーン固化物である。

#### 【実施例】

#### 【0047】

本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

##### 1. 球状被覆酸化マグネシウム粉末

###### 合成例 1

結晶子径が $5.3 \times 10^{-9}$  mの単結晶の集合体である酸化マグネシウム粉末（タテホ化学工業株式会社製KMAO-H）を、衝撃式粉碎機を用いて、粒径 $100 \times 10^{-6}$  m以下に粉碎した。ヒュームドシリカ（純度99.9%以上、比表面積 $200 \pm 20 \text{ m}^2/\text{g}$ ）を、酸化マグネシウムに対して混合比が10 mass%になるように湿式添加し、400～500 rpmで600 s攪拌混合した。攪拌混合後、ろ過、脱水して得られたケーキを、乾燥機を用いて、423 Kで一晩乾燥した。乾燥したケーキをサンプルミルで解碎して、原料の酸化マグネシウム粉末と同程度の粒径に調整し、被覆酸化マグネシウム粉末を得た。

###### 合成例 2

ヒュームドシリカの混合比を3 mass%とした以外は上記合成例1と同様にして被覆酸化マグネシウム粉末を得た。

###### 合成例 3

ヒュームドシリカの混合比を30 mass%とした以外は上記合成例1と同様にして被覆酸化マグネシウム粉末を得た。

###### 合成例 4

結晶子径が $5.3 \times 10^{-9}$  mの単結晶の集合体である酸化マグネシウム粉末（タテホ化学工業株式会社製KMAO-H）を、衝撃式粉碎機を用いて、粒径 $100 \times 10^{-6}$  m以下に粉碎した。4%硝酸アルミニウム水溶液（関東化学株式会社製特級試薬）を、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ に換算して、酸化マグネシウムに対して混合比が10 mass%になるように湿式添加し、400～500 rpmで600 s攪拌混合した。攪拌混合後、ろ過し、ケーキができ始めたところで、残留硝酸アルミニウムを除去するため、十分に水洗し、脱水して得られたケーキを、乾燥機を用いて、423 Kで一晩乾燥した。乾燥したケーキをサンプルミルで解碎して、原料の酸化マグネシウム粉末と同程度の粒径に調整し、被覆酸化マグネシウム粉末を得た。

###### 合成例 5

硝酸アルミニウムに替えて、硝酸鉄水溶液を、 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ に換算して、酸化マグネシウムに対して混合比が15 mass%となるように配合した以外は、上記合成例4と同様にして、被覆酸化マグネシウム粉末を得た。

#### 【0048】

###### 実施例 1

合成例1で作製した粉末を、液化プロパンガスと酸素との燃焼により形成した高温火炎

中に供給し、溶融・球状化処理を行い、フォルステライト ( $Mg_2SiO_4$ ) で被覆した球状被覆酸化マグネシウム粉末を得た。

#### 実施例 2

合成例 2 で作製した粉末を使用したこと以外は上記実施例 1 と同様にして溶融・球状化処理を行い、フォルステライト ( $Mg_2SiO_4$ ) で被覆した球状被覆酸化マグネシウム粉末を得た。

#### 実施例 3

合成例 3 で作製した粉末を使用したこと以外は上記実施例 1 と同様にして溶融・球状化処理を行い、フォルステライト ( $Mg_2SiO_4$ ) で被覆した球状被覆酸化マグネシウム粉末を得た。

#### 実施例 4

合成例 4 で作製した粉末を使用したこと以外は上記実施例 1 と同様にして溶融・球状化処理を行い、スピネル ( $Al_2MgO_4$ ) で被覆した球状被覆酸化マグネシウム粉末を得た。

#### 実施例 5

合成例 5 で作製した粉末を使用したこと以外は上記実施例 1 と同様にして溶融・球状化処理を行い、マグネシウムフェライト ( $Fe_2MgO_4$ ) で被覆した球状被覆酸化マグネシウム粉末を得た。

### 【0049】

#### 比較例 1

合成例 1 で得られた粉末を、空気中で 1723K で 3600s 焼成した後、再度、サンプルミルにて解碎して、原料の酸化マグネシウム粉末と同程度の粒径に調整し、フォルステライト ( $Mg_2SiO_4$ ) で被覆した被覆酸化マグネシウム粉末を得た。

#### 比較例 2

酸化マグネシウム粉末を、液化プロパンガスと酸素との燃焼により形成した高温火炎中に供給し、表面が被覆されていない酸化マグネシウム粉末を得た。

### 【0050】

#### 評価試験

上記各実施例 1 ~ 5 及び比較例 1, 2 で得られた酸化マグネシウム粉末試料の平均形状係数、複酸化物の含有量、BET 比表面積、平均粒径及び耐湿性の各項目を測定し、結果を表 1 に示した。なお、各項目の測定方法を下記に示す。

平均形状係数：超深度形状測定顕微鏡「VK8550」（株式会社キーエンス製）を用いて粒子像を撮影し、画像解析ソフト「EASY32」（株式会社ライブラリー製）により、粒子 100 個の形状係数を測定し、その平均値を平均形状係数とした。

粉末表面の複酸化物の含有量：走査型蛍光 X 線分析装置「ZSX-100e」（理学電機工業株式会社製）を用いて、粉末試料に含まれる元素の含有量を測定し、複酸化物の含有量に換算した。

BET 比表面積：ガス吸着法により、流動式比表面積測定装置「フローソープ II 2300」（株式会社島津製作所製）を用いて、粉末試料の比表面積を測定した。

平均粒径：レーザー回折・散乱法により粒度分布測定装置「マイクロトラック HRA」（日機装株式会社製）を用いて、粉末試料の体積平均粒径を測定した。

耐湿性試験：得られた試料  $5 \times 10^{-3} kg$  を、温度 373K の沸騰水  $100 \times 10^{-6} m^3$  中で 2 時間攪拌し、質量増加率 (mass%) を測定して、耐湿性を評価した。

### 【0051】

【表1】

		球状被覆酸化マグネシウム				
	複酸化物	含有量 (mass%)	平均形状係数	平均粒径 (10 <sup>-6</sup> m)	BET 比表面積 (10 <sup>3</sup> m <sup>2</sup> /kg)	質量増加率 (mass%)
実施例 1	Mg <sub>2</sub> SiO <sub>4</sub>	17.49	1.186	21.01	0.75	2.97
実施例 2	Mg <sub>2</sub> SiO <sub>4</sub>	6.56	1.242	20.24	0.54	4.12
実施例 3	Mg <sub>2</sub> SiO <sub>4</sub>	48.52	1.154	21.77	0.83	1.37
実施例 4	Al <sub>2</sub> MgO <sub>4</sub>	21.76	1.194	20.45	0.78	2.77
実施例 5	Fe <sub>2</sub> MgO <sub>4</sub>	21.00	1.190	20.21	0.31	1.08
比較例 1	Mg <sub>2</sub> SiO <sub>4</sub>	18.45	1.262	20.45	0.48	3.19
比較例 2	—	—	1.289	21.09	0.81	7.34

## 【0052】

## 2. 樹脂組成物

## 実施例 6

実施例 1 で作製した試料粉末に、エポキシシランを 1.0 mass% 添加し、600 s 揚拌混合して粉末を表面処理し、次いで 423 K で 7200 s 乾燥させた。得られた試料 560 重量部を、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂 63 重量部、ノボラック型フェノール樹脂 34 重量部、トリフェニルホスフィン 1 重量部及びカルナバワックス 2 重量部と、擂潰機を用いて、600 s 混合粉碎した。その後、混合物を二本ロールを用いて、373 K で 300 s 混練し、次いでこの混練物を 10 メッシュ以下に更に粉碎し、φ3

$8 \text{ mm} \times t 15 \text{ mm}$  のペレットを作製した。このペレットを、 $7 \text{ MPa}$ 、 $448 \text{ K}$ で $180 \text{ s}$ 間、トランスファー成型し、下記の方法でスパイラルフローを測定した。

また、このペレットを $448 \text{ K}$ で $180 \text{ s}$ 、 $7 \text{ MPa}$ でトランスファー成型し、次いで $453 \text{ K}$ で $18 \times 10^3 \text{ s}$ 間ポストキュアを行い、 $\phi 50 \text{ mm} \times t 3 \text{ mm}$ の成型体を得た。

#### 実施例 7

実施例 2 で作製した球状被覆酸化マグネシウム粉末を使用したこと以外は上記実施例 6 と同様にして、スパイラルフローを測定し、成型体を得た。

#### 実施例 8

実施例 3 で作製した球状被覆酸化マグネシウム粉末を使用したこと以外は上記実施例 6 と同様にしてスパイラルフローを測定し、成型体を得た。

#### 実施例 9

実施例 4 で作製した球状被覆酸化マグネシウム粉末を使用したこと以外は上記実施例 6 と同様にして、スパイラルフローを測定し、成型体を得た。

#### 実施例 10

実施例 5 で作製した球状被覆酸化マグネシウム粉末を使用したこと以外は上記実施例 6 と同様にして、スパイラルフローを測定し、成型体を得た。

#### 比較例 3

比較例 1 で作製した試料を用いた以外は、実施例 6 と同様にして、スパイラルフローを測定し、成型体を得た。

#### 比較例 4

酸化マグネシウム粉末に代えて、アルミナ粉末を用いた以外は、実施例 6 と同様にして、スパイラルフローを測定し、成型体を得た。

#### 実施例 11

実施例 1 で作製した試料粉末に、ビニルトリメトキシシランを $1.0 \text{ mass\%}$ 添加し、 $600 \text{ s}$ 攪拌混合して粉末を表面処理し、次いで $423 \text{ K}$ で $7200 \text{ s}$ 乾燥させた。得られた試料 451 重量部を、二液型 RTV シリコーンゴム 100 重量部と、二本ロールを用いて $300 \text{ s}$ 混練した。次いで、白金触媒 5 重量部を添加し、二本ロールを用いて $600 \text{ s}$ 混練して、コンパウンドを作製し、下記に示す条件で粘度を測定した。これを $393 \text{ K}$ で $600 \text{ s}$ 、 $5 \text{ MPa}$ でプレス成型し、 $\phi 50 \text{ mm} \times t 3 \text{ mm}$ の成型体を得た。

#### 比較例 5

比較例 1 で作製した試料粉末を用いた以外は、実施例 11 と同様にして、粘度を測定し、成型体を得た。

#### 比較例 6

酸化マグネシウム粉末に代えて、アルミナ粉末を用いた以外は、実施例 11 と同様にして、粘度を測定し、成型体を得た。

#### 【0053】

##### 評価試験

上記各実施例 6～11 及び比較例 3～6 で得られた樹脂組成物のスパイラルフロー又は粘度（常温での樹脂の状態により適切な測定方法を選択した。）、ならびに、これらの樹脂組成物の成型体の熱伝導率、耐湿性及び耐湿性試験後の外観を測定し、結果を表 2 に示した。なお、上記各項目の評価方法は以下の通りである。

スパイラルフロー：EMMI-I-I-66 に準じて、測定した

粘度：レオメータ「VAR-50」(REOLOGICA 社製) を用いて、粘度を測定し、Shear rate が $1 \text{ s}^{-1}$ の値とした。

熱伝導率：レーザーフラッシュ法により、熱定数測定装置「TC-3000」(真空理工株式会社製) を用いて、成型体の熱伝導率を測定した。

耐湿性試験：成型体を温度 $358 \text{ K}$ 、湿度 $85\%$ に設定した恒温恒湿器に 7 日間保管し、吸湿率を測定した。また外観を目視により観察した。

#### 【0054】

【表2】

複酸化物	樹脂	樹脂組成物の流動性			成形体の評価試験		
		スパイラル フロー (m)	粘度 (Pa・s)	熱伝導率 (W/mK)	吸湿率 (mass%)	耐湿性試験 後の外観	
実施例 6	Mg <sub>2</sub> SiO <sub>4</sub>	エポキシ樹脂	0.507	—	3.11	0.18	異常なし
実施例 7	Mg <sub>2</sub> SiO <sub>4</sub>	エポキシ樹脂	0.448	—	3.25	0.20	異常なし
実施例 8	Mg <sub>2</sub> SiO <sub>4</sub>	エポキシ樹脂	0.653	—	3.03	0.11	異常なし
実施例 9	Al <sub>2</sub> MgO <sub>4</sub>	エポキシ樹脂	0.535	—	3.12	0.15	異常なし
実施例 10	Fe <sub>2</sub> MgO <sub>4</sub>	エポキシ樹脂	0.492	—	3.15	0.14	異常なし
比較例 3	Mg <sub>2</sub> SiO <sub>4</sub>	エポキシ樹脂	0.343	—	3.18	0.17	異常なし
比較例 4	— <sup>(*)</sup>	エポキシ樹脂	0.502	—	2.78	0.15	異常なし
実施例 11	Mg <sub>2</sub> SiO <sub>4</sub>	シリコーンゴム	—	471	2.20	0.20	異常なし
比較例 5	Mg <sub>2</sub> SiO <sub>4</sub>	シリコーンゴム	—	3280	2.14	0.20	異常なし
比較例 6	— <sup>(*)</sup>	シリコーンゴム	—	1130	1.70	0.16	異常なし

(\*) : 被覆 MgO 粉末に代えて、被覆のない Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粉末を使用

## 【0055】

以上の結果から明らかなように、本発明の平均形状係数を満足する球状被覆酸化マグネシウム粉末（表1、実施例1～5）は、耐湿性に優れている。そして、これらの粉末を充填してなる樹脂組成物（表2、実施例6～11）は、流動性に優れており、さらに、その成型体は高い熱伝導率を有し、耐湿性に優れていることが確認された。

一方、比較例1の粉末は、耐湿性は優れていたが、平均形状係数は1.25以上である

。これをエポキシ樹脂に充填した場合（表2、比較例3）、及びシリコーンゴムに充填した場合（表2、比較例5）共に、流動性が低い値となった。

比較例2の粉末は複酸化物で被覆されていないので、表1に示したように耐湿性が非常に低いものであった。

また、酸化マグネシウム粉末に替えて従来のアルミナ粉末を充填して得られた樹脂組成物（表2、比較例4，6）は、流動性及び耐湿性は優れているものの、熱伝導性に劣っていた。

#### 【0056】

以上詳細に説明したように、本発明の球状被覆酸化マグネシウム粉末は、耐湿性に優れ、かつ充填材として用いるとき、充填性に優れ、樹脂へ高充填することができ、熱伝導性フィラーとして有用である。

また、この球状被覆酸化マグネシウム粉末を充填して得られた樹脂組成物は、流動性に優れており、その成型体は高い放熱性及び耐湿性を有するため、様々な電子デバイスの封止材又はスペーサー、接着剤又は接着性シート、あるいは樹脂回路基板、金属ベース回路基板、金属張積層板、内層回路入り金属張積層板等の構成部材として非常に有用であり、その工業的価値は極めて高い。

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 耐湿性に優れ、かつ樹脂への充填材として用いるとき、充填性及び流動性に優れた球状被覆酸化マグネシウム粉末を提供すること。また、そのような球状被覆酸化マグネシウム粉末を容易に製造すること。さらに、その粉末を含む樹脂組成物及びその樹脂組成物を用いた電子デバイスを提供すること。

【解決手段】 複酸化物により被覆され、かつ、平均形状係数が1.25以下であることと特徴とする球状被覆酸化マグネシウム粉末。

酸化マグネシウム粉末の表面に、複酸化物を形成する元素の化合物を存在させたのち、高温で溶融させることにより、前記マグネシウム粉末表面を複酸化物で被覆すると共に球状化する、球状被覆酸化マグネシウム粉末の製造方法。

この球状被覆酸化マグネシウム粉末を含む樹脂組成物及びその樹脂組成物を用いた電子デバイス。

【選択図】 なし

特願 2003-346083

出願人履歴情報

識別番号 [000108764]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住所 兵庫県赤穂市加里屋字加藤974番地  
氏名 タテホ化学工業株式会社